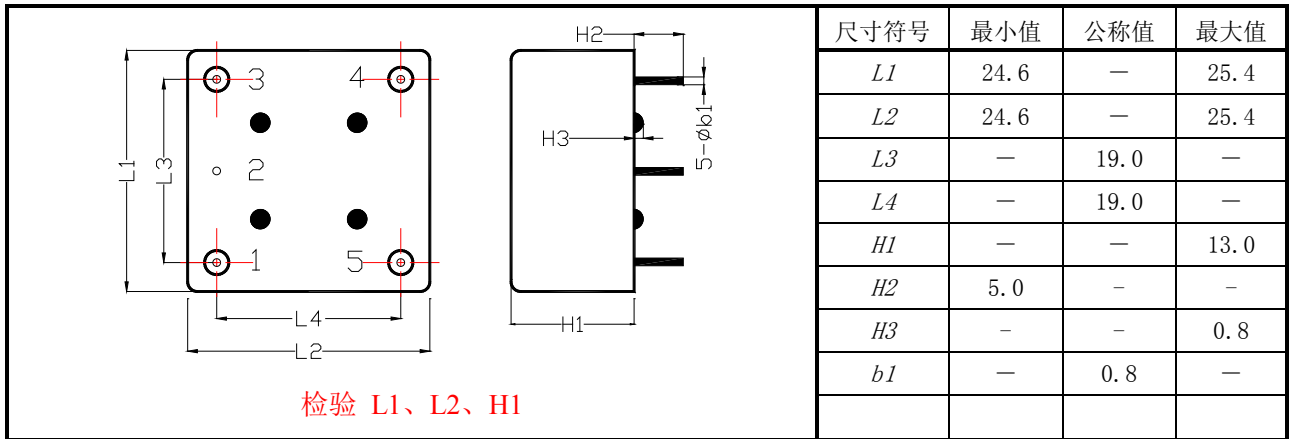




## 外形尺寸 (mm, 底视图, 引脚编号仅为示意)

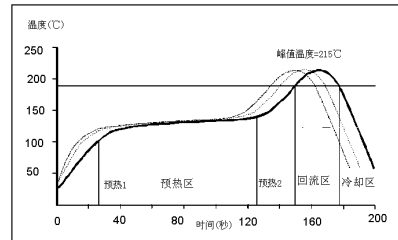


## 极限参数

最大电源电压	7V	引线耐焊接温度 (手工焊)	300°C(10s)
--------	----	---------------	------------

## 推荐装配方法

- 1) 按 QJ 3267-2006 要求对产品引线搪锡, 建议使用控温电烙铁操作;
- 2) 建议使用 63Sn/37Pb 或 62Sn36Pb2Ag 焊膏或焊锡丝;
- 3) SMD 结构产品采用再流焊方式装配时, 推荐按右图再流焊曲线设定炉温, 进行炉温测量后焊接; 其它结构建议手工焊接安装;
- 4) 输入、输出引线使用手工焊接(注意先装配、固定壳体, 再手工焊接引线), 建议使用控温电烙铁进行操作, 温度按 QJ 3117 要求操作。



## 推荐清洗方法

建议使用软毛刷蘸无水乙醇进行清洗, 不能在水乙醇等清洗液中浸泡, 不建议气相清洗, 应避免超声清洗。清洗后自然晾干, 也可在不高于 85°C 干燥箱中烘干。

## 常见问题及注意事项

- ◇ 电源噪声经调制将转换为振荡器的附加相位噪声。为得到最佳的相位噪声, 建议选用线性稳压电源 (如 LDO) 供电, 同时在晶振电源引脚焊盘就近使用不低于 1uF 的电容进行滤波, 电容应选择低 ESR 的电容 (最好是钽电容), 工作电流较大的晶振 (如 OCXO) 应选用 10uF 或更大容值的电容。
- ◇ 所有 SMD 结构产品应注意 PCB 焊盘连接设计, 标注为悬空 (NC 或 NULL) 的引脚应避免电连接到地或高电平, 不正确的连接可能引起产品功能异常。
- ◇ 晶振内部装有使用导电胶固定的、很薄的石英晶片, 当受到大的冲击时 (如从工作台面跌落到硬地面), 便可能引起导电胶开裂、晶片断裂、破损等, 导致产品失效或超出规范值; 强烈的振动 (如振动等环境试验时 PCB 板发生了共振) 也可能出现类似现象。如发生此类现象可联系厂家寻求技术支持。
- ◇ 使用过程中出现频率不稳、波动大、或频率超出规范值时, 除产品本身原因外, 应检查电源电压是否过低、是否存在非密封产品的浸泡等清洗操作、外部校频引脚连接是否正确、各引脚是否接触良好、负载是否偏离按规格书要求; 采用外部电压调节时应检查电压是否稳定 (mV 的波动即有影响), 外接电位器调节时应选用低温漂的多圈精密电位器, 抵挡的电位器会引起相噪恶化、频率来回漂移等现象。

722 所

中国电科 13 所  
拟制:

审核:

请签字回传

技术支持: 0311-83933252、3188 传真: 0311-83933424 E-mail: [contact@hbmm.com](mailto:contact@hbmm.com) (请注明 收件人)  
联系电话: 牛占鲁 13933840223 王占奎 15512174029 刘兰坤 15512112173